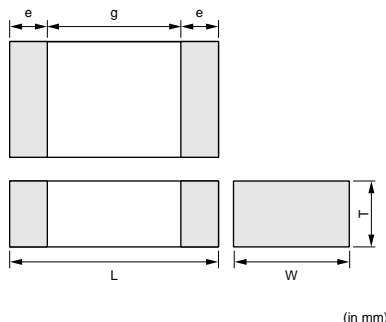


積層セラミックコンデンサ

GRM21BB11E334KA01□ (2012, B, 0.33 μ F, 25Vdc)

□は包装仕様コードが入ります。

RoHS指令対応品



外形寸法

L寸法	2.0mm \pm 0.1mm
W寸法	1.25mm \pm 0.1mm
T寸法	1.25mm \pm 0.1mm
外部電極幅e	0.2 ~ 0.7mm
外部電極間距離g(以上)	0.7mm

定格値

温度特性コード	B1
温度特性(準拠規格)	B (JIS)
温度特性変化率	\pm 10%
静電容量	0.33 μ F \pm 10%
定格電圧	25Vdc

包装仕様

コード	包装仕様	最小受注単位数
L	180mmエンボステーピング	3000
K	330mmエンボステーピング	10000
C	バルクケース	5000
B	パラ袋	1000

性能

PDFファイル「性能および試験方法」をご参照ください。

当データシートは、一般電子機器に使用されるめっきタイプチップ積層セラミックコンデンサに適用します。

「使用上の注意」

外部電極すず(Sn)めっき品の場合、すず(Sn)の融点より低い温度ではんだ付けを行うと、外部電極へのはんだ濡れ性が低下し、はんだ付け不良の原因となる場合があります。かならず実装評価を実施して、はんだ付け性をご確認ください。
Sn-Zn系はんだは、チップ積層セラミックコンデンサの信頼性に悪影響を与えます。Sn-Zn系はんだをご使用される際は、事前に当社までご連絡ください。

- ・「RoHS指令対応」とは、EU指令DIRECTIVE2002/95/ECに基づいて判断し、規制対象外と自然界に存在するレベルの不純物を除き、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、PBB、PBDEを含有しないことを指します。
- ・この対応状況は、RoHS指令を受けて整備されるEUの各加盟国の法令への適合を保証するものではありません。

④お願い

1. 当データシートは、株式会社村田製作所のWEBサイトからダウンロードされたものです。記載内容について、改良のため予告なく変更することや供給を停止することがございますので、ご注文に際してはご確認ください。
2. 当データシートには、紙面の都合上代表的な仕様しか記載しておりませんので、ご注文にあたっては詳細な情報が記載されている納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

2006.3.9